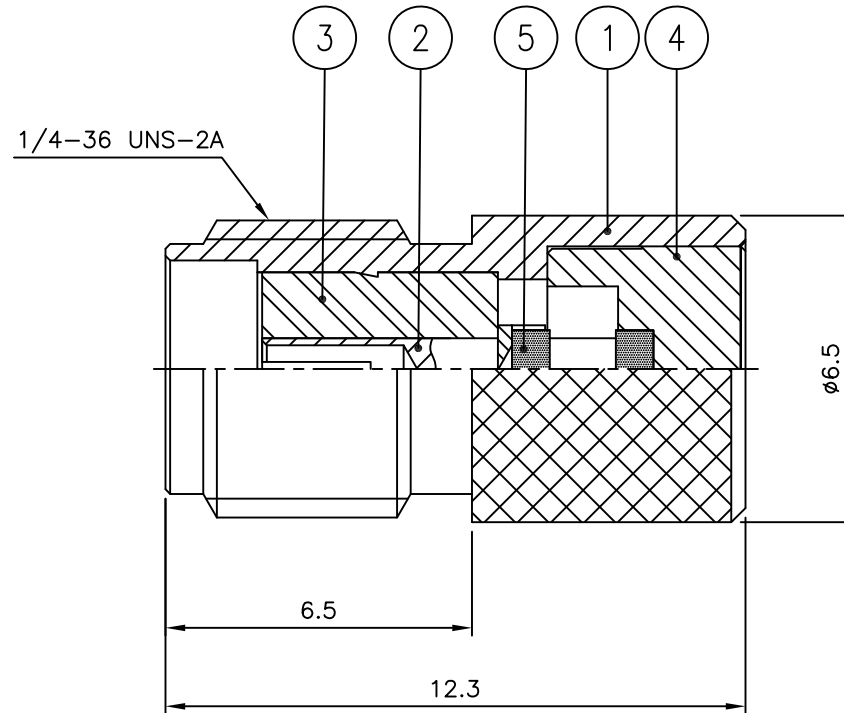


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	S.Y.EUN	I.C.KIM	2018.05.02.
1	[설변No.202301-0002] 핀 + 저항 조립성 개선으로 인한 조립부 치수 변경	S.Y.EUN	S.H.KIM	2023.01.12.

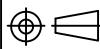


ELECTRICAL DATA		
1	IMPEDANCE	50Ω Nominal
2	FREQUENCY	DC ~ 6GHz
3	V.S.W.R	1.2 : 1 (MAX)
4	RATING POWER	1 Watt

* 조립 주기

- ①번 BODY에 ④번 COVER를 억지끼움 조립한다.
- ②번 PIN 과 ⑤번 RESISTOR를 조립한다. (PIN+저항 조립 JIG : TL00057-7/1)
- 위 1번 사항과 2번 사항을 조립한다. (RESISTOR 약한 억지끼움)
- ③번 TEFLON을 ①번 BODY에 조립한다.
- 멀티 미터기로 순수 저항 값을 확인한다.
(47~53 Ω)

5	RESISTOR	1	—	—	DRE00057-N/1
4	COVER	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCV00094-5/1
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02892-N/1
2	CONTACT	1	BeCu C17300	Gold Plate	DCT00276-5/2
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DBD00374-5/2
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.2	DATE 2023. 01. 12.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017	
	Angle ±1°	APPROVED BY	S.H.KIM		
MATERIAL	—	CHECKED BY		TITLE SMA50 (J) 1W TERMINATION	
FINISH	—	DRAWN BY	S.Y.EUN		
SCALE 6/1		UNIT mm		A4	DWG NO. TM00070-7/2
				REVISION 1	SHEET 1 of 1